

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



## 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员名称	天风证券 文毓；招商证券 李亚明；兴业证券 温佳贝；浙商证券 王龙；国海证券 马嘉艺；融通基金 卢文杰、任涛、王迪、陈甲铨；博普资产 刘世昌；鹏华基金 王天铄；景顺长城基金 林昕阳；大成基金 吴天齐；丹羿投资 宝玥娇；华润元大基金 陈方圆；Fidelity Luke；中颖投资 戴晶晶。
时间	2026年4月27日下午14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书：钟科先生 证券事务代表：潘露璐女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、2026年一季度营收、净利润双增，扣非净利增速达46.24%，改善驱动因素是什么？</b></p> <p>答：公司2026年一季度业绩实现显著改善，核心原因在于定价模式的优化。面对原材料价格上涨，公司价格传导更为及时，毛利率回升至17.71%，较去年同期提升1.46个百分点。</p> <p><b>2、请问公司产品在光模块领域是否有运用？有哪些比较重要的客户？</b></p> <p>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大</p>

环节：一是光器件（如 TOSA、ROSA）的 SMT 贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是 PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。

### **3、公司 2025 年研发投入金额及占比如何？研发重点方向与核心技术突破有哪些？**

答：公司 2025 年度研发费用约 4,009.79 万元，同比上升 21.88%。经过多年深耕细研，公司在超细粒度焊接材料、低温高可靠焊接材料、光伏组件焊接材料、辅助焊接材料及水基清洗剂等关键技术领域实现了突破。

公司将持续加大高端微电子焊接材料、半导体封装材料、可靠性材料等领域研发与产品迭代，推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应用，为业务增长提供技术支撑。

### **4、作为龙头企业，请问公司在国产替代方面的计划和成就？**

答：面对国际形势变化，国产替代已成为产业升级的必然趋势，下游客户对国产材料的接纳与应用意愿持续增强。公司通过持续加大研发投入，部分核心产品性能已达到国际先进水平，成功实现对国外同类产品的替代。这些产品已应用于半导体、汽车电子、储能、新能源、AI 算力等关键领域，同时帮助公司建立了品牌影响力，占据了相应的市场份额。公司将继续聚焦技术突破，进一步提升产品的稳定性与性价比；同时深化与下游客户的合作，推动国产材料更广泛地融入客户的研发与生产流程，加速全产业链的国产替代进程。

### **5、公司目前的产能利用率如何？**

	<p>答：公司各主要产品线均根据客户订单需求，合理有序地组织生产与出货。当前，各产线产能利用率因产品类型及工艺环节差异而有所不同，但整体均处于正常高效的运行区间。未来，公司将持续紧贴市场需求，积极拓展客户资源、扩大订单规模，进一步提升产能利用率与运营效率，为客户创造更大价值。</p>
附件（如有）	
日期	2026年4月27日